

2012年(平成24年)4月6日(金曜日)

日 刊



発行所 電波新聞社
 東京本社
 東京都品川区東五反田1-11
 -15 〒141-8715
 ☎03(3445)6111(大代表)

大阪本社
 大阪府中央区北浜3-2-25
 (京阪淀屋橋ビル6階) 〒541-0041
 ☎06(6203)3361(大代表)

西部本社
 福岡市博多区博多駅前2-13
 -23(扇寿ビル) 〒812-0011
 ☎092(431)7411(大代表)

©電波新聞社 2006

千住金属工業

ソルダーボールに注力

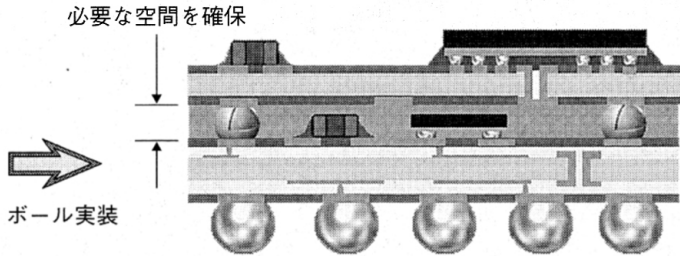
3次元実装向け「銅核ボール」開発

千住金属工業は、はんだ材料の技術を応用したソルダーボールのビジネスを強化しており、その一環として3次元実装向けに銅ボールにはんだメッキを施した「銅核ボール」を開発、市場への普及に乗り出している。

ソルダーボール(マイク) ケーシの部品接続に用いるスマートフォンやタブレットPCに代表されるモバイル機器の急速な普及で需要拡大が期待される。



部品内蔵3D実装への応用



銅核ボールを用いた部品内蔵の基板例

同社は、独自のシリスポーラスガラスを利用した膜乳化法で狭公差高真球度のソルダーボールを製造しており、昨年には宮崎工場(千住技術)で量産体制も整えた。

長谷川永悦社長は「半導体の微細化を大きな課題として取り組んでいる。バンプ形成のソルダーボールはボール径が100μmから最小20μmまで、用途に応じたメッキは、



長谷川 社長

て多様な種類が可能。同社は「セミコンジャパ」や「セミコンチャイナ」など、半導体関連の展示会でも積極的にアピールし、市場の拡大に取り組んでいる。